附件3

## **印制电路板行业规范条件企业年度自查报告**

企业名称： （加盖公章）

企业地址：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

填表日期 ： 年 月 日

### 一、企业基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 无变更□ 变更□ 变更后名称： |
| 股权结构情况 | 无变更□ 变更□ （需填写前三名股东名称及持股比例）1.2.3. |
| 企业经营范围 | 无变更□ |
| 变更□（勾选现经营类型）单面板□ 双面板□ 多层板□ HDI□ 挠性板□ 刚-挠结合板□ IC载板□ 金属基板□ 样板、小批量板、特色板□  |
| 是否上市公司 | 否□ |
| 是□ | 申报时已上市□申报时未上市□（需注明上市地点及代码） |
| 是否航天、航空、军工配套 | 否□ |  |
| 是□ | 申报时已配套□申报时未配套□ |
| 是否采用全印制电子技术制造工艺项目 | 否□ |  |
| 是□ | 申报时已采用□申报时未采用□ |
| 法人代表 | 无变更□ 变 更□ （需注明变更人） |
| 职工总数（人） |  | 其中技术人员人数 |  |
| 上年度总资产（万元） |  | 所在产业园区及地址 |  |
| 上年度期末流动资产（万元） |  | 上年度负债总额（万元） |  |
| 上年度期末流动负债（万元） |  | 上年度经营活动产生的现金流量净额（万元） |  |
| 上年度主营业务收入（万元） |  | 上年度利润总额（万元） |  |
| 上年度存货（万元） |  | 企业研发投入（含工艺改进（万元） |  |
| 专利数量（已授权） | 发明专利数量 |  |
| 实用新型专利数量 |  |
| 外观设计专利数量 |  |

###

### 二、项目变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主营产品类型 | 原有：现有： |
| 生产线变更情况 | 1. 单面板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 2. 双面板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 3. 多层板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 4. HDI无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 5. 挠性板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 6. 刚-挠结合板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 7. IC载板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 8. 金属基板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）： 9.样板、小批量板、特色板无变更□ 原有生产线 条变 更□ 合计现有生产线 条新增生产线 条， 投产日期 ，投资金额 万元改扩建生产线 条，投产日期 ，投资金额 万元新建及改扩建项目产出投入比（年产值/项目总投资）：  |
| 产品类型 | 产品类型 | 占比(%) | 人均产值（万元人民币/年•人） | 上一年产能(万平方米) | 上一年产量(万平方米) | 预计本年产能(万平方米) | 预计本年产量(万平方米) |
| 单面板□ |  |  |  |  |  |  |
| 双面板□ |  |  |  |  |  |  |
| 多层板□ |  |  |  |  |  |  |
| HDI □ |  |  |  |  |  |  |
| 挠性板□ |  |  |  |  |  |  |
| 刚-挠结合板□ |  |  |  |  |  |  |
| IC载板□ |  |  |  |  |  |  |
| 金属基板□ |  |  |  |  |  |  |
| 样板、小批量板、特色板□ |  |  |  |  |  |  |
| 备注（可另附页）： 如是航天、航空、军工等行业用印制电路板产品的生产企业，以及采用全印制电子技术制造工艺的项目等，详细描述产品特点、市场份额等信息) |

三、关键技术指标和加工能力

|  |  |
| --- | --- |
| 是否变更 | 无变更□ 变更□ |
| 单面板□ | 最小线宽/间距： μm / μm，最小孔径： μm，最小阻焊桥： μm； |
| 双面板□ | 最小外层线路： μm / μm，最小孔径： μm，最小阻焊开窗： μm，最小阻焊桥： μm，最小孔厚径比： ； |
| 多层板□ | 最小外层线路： μm / μm，最小内层线路： μm，最小孔径： μm，最小阻焊开窗： μm，最小阻焊桥： μm，最小孔厚径比： ，钻孔位置精度： μm； |
| HDI □ | 最小外层线路： μm / μm，最小内层线路： μm / μm，最小阻焊开窗： μm，最小阻焊桥： μm，最小BGA节距： μm，最小盲孔孔径： μm，钻孔位置精度： μm； |
| 挠性板□ | 最小线宽/间距： μm / μm，最小孔径： μm； |
| 刚-挠结合板□ | 最小外层线路： μm / μm，最小内层线路： μm / μm，最小阻焊开窗： μm，最小阻焊桥： μm，最小钻孔厚径比： ；  |
| 金属基板□ | 最小外层线路： μm / μm，最小孔径： μm，最小阻焊开窗： μm，最小阻焊桥： μm。 |

####

### 四、企业管理情况

|  |  |
| --- | --- |
| 生产规模是否符合规范条件 | 是□ 否□ 存在问题： |
| 工艺技术是否符合规范条件 | 是□ 否□ 存在问题： |
| 质量管理是否符合规范条件  | 是□ 否□ 存在问题： |
| 智能制造是否符合规范条件 | 是□ 否□ 存在问题： |
| 绿色制造是否符合规范条件 | 是□ 否□ 存在问题： |
| 节能节地、资源综合利用和环境保护是否符合规范条件 | 是□ 否□ 存在问题： |
| 安全生产和职业卫生是否符合规范条件 | 是□ 否□ 存在问题： |
| 社会责任是否符合规范条件 | 是□ 否□ 存在问题： |
| 监督与管理是否符合规范条件相关条款\* | 是□ 否□ 存在问题： |

注：\*指《印制电路板行业规范条件》第九条（一）、（二）

### 五、企业年度报告

|  |
| --- |
| 至少包括但不限于企业生产经营情况，安全生产、管理情况和产品质量情况，技术研发和技术改造（包括知识产权情况）、市场份额情况等（字数不限）1. 企业生产经营情况

（产能、产量、营收、利润、负债、市场份额等）1. 企业安全生产和职业卫生管理情况
2. 企业产品质量控制情况
3. 企业节能节地、资源综合利用和环境保护情况
4. 企业在绿色制造、智能制造方面的建设情况

六、本年度投资计划、生产建设规划等负责人签名： （单位公章） 年 月 日(可附页) |